

中国国际金融股份有限公司
关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市的
上市保荐书

保荐机构（主承销商）



北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2026年2月

中国国际金融股份有限公司

关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书

深圳证券交易所：

托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司（以下简称“托伦斯”、“公司”或“发行人”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市（以下简称“本次证券发行”或“本次发行”），并已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”、“保荐机构”、“本机构”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构。

中金公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《首发办法》”）、《深圳证券交易所股票发行上市审核业务指引第2号——上市保荐书内容与格式》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）等法律法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。

（本上市保荐书中如无特别说明，相关用语具有与《托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（申报稿）》中相同的含义）

目 录

目 录	2
一、发行人基本情况.....	3
二、申请上市股票的发行情况.....	20
三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况.....	20
四、保荐机构与发行人之间的关联关系.....	21
五、保荐机构承诺事项.....	22
六、本次发行履行了必要的决策程序.....	23
七、针对发行人是否符合创业板定位要求及国家产业政策的核查情况.....	24
八、保荐机构关于发行人是否符合《创业板上市规则》规定的上市条件的逐项说明	27
九、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排.....	28
十、保荐机构认为应当说明的其他事项.....	29
十一、保荐机构对本次上市的推荐结论.....	29

一、发行人基本情况

（一）基本信息

公司名称	托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司
注册地址	江苏省南通市启东市汇龙镇新洪路 1000 号
有限公司成立日期	2017 年 1 月 23 日
股份公司成立日期	2024 年 7 月 29 日
联系电话	0513-83881000
经营范围	半导体设备、光学设备、医疗设备、精密机械设备及零配件研发、制造、销售，半导体设备维修，提供半导体领域内的技术研发、技术咨询、技术转让服务，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
本次证券发行类型	首次公开发行股票并在创业板上市

（二）主营业务

公司是国内领先的精密金属零部件的研发、生产和销售的综合服务商，致力于为半导体设备提供高性能的关键工艺零部件、工艺零部件、结构零部件、气体管路及系统组装产品等，同时，公司工艺能力覆盖激光设备领域，可提供高功率激光器所需的激光器腔体和冷却工艺零部件产品。

在产品类型上，公司凭借多品类半导体设备金属零部件产品建立了独特竞争优势。在对技术及工艺水平要求极高的半导体关键工艺零部件生产上，公司不仅量产腔体、内衬、加热器、匀气盘等关键工艺零部件，更成功实现了冷盘、多管式加热反射罩、气体分布盘、静电卡盘基体等“多层结构、大截面、复杂水路及气路”复杂结构的关键工艺零部件生产。同时，公司产品应用领域横向拓展至高功率激光设备领域，可提供激光器腔体等核心部件，展现了强大的技术跨领域复用能力。

在技术工艺能力上，公司整体工艺水平位居国内厂商第一梯队，核心技术全面覆盖高精度机械制造、焊接及表面处理三大领域，并进一步形成了复杂精密零部件工艺整合与检测能力。在焊接方面，依托与头部客户的长期协同开发与技术迭代，公司以真空钎焊为代表的多样化焊接工艺处于境内领先地位，尤其擅长多层叠加、多流道结构及不同材质合金的复合钎焊，能够满足复杂精密零部件对精度、洁净度与可靠性的严苛要求。在表面处理和机械加工方面，公司通过阳极氧化、半导体级高洁净清洗等先进表面处理工艺，结合复杂结构精密加工与微细孔精密制造等高精度机加工技术，共同确保关键零

部件在耐腐蚀性、尺寸精度、表面洁净度与密封性等方面达到行业领先水平。基于以上核心技术的系统整合，公司实现了从工艺设计、制造到多维度检测验证的一体化交付，该复杂精密零部件工艺整合与检测能力已获得国内头部半导体设备厂商的高度认可，全面支撑半导体设备对高性能复杂精密零部件的需求。

在客户方面，公司深度服务本土半导体设备厂商，多款产品已进入北方华创、中微公司等客户半导体设备的供应体系并应用于刻蚀设备、薄膜沉积设备、抛光设备、退火设备等核心设备，覆盖逻辑芯片工艺设备、存储芯片工艺设备及先进封装等领域。此外，公司亦成功导入国际知名激光设备企业 Lumentum 的供应链，展现公司技术的国际竞争力。

当前全球人工智能与算力需求的爆发，正在推动以算力芯片为代表的逻辑芯片以及存储芯片的产能扩张与技术迭代。具体而言，逻辑芯片持续向更先进工艺节点发展，而存储芯片为应对海量数据需求，正进行大规模产能扩张及制程升级，并且两者带动了对先进封装工艺的配套需求，直接拉动了对上游半导体设备的需求。在我国持续布局“人工智能+”战略引领下，我国晶圆制造产能建设、半导体设备需求有望保持高景气，与此同时，半导体设备国产化率稳步提升，为本土设备厂商带来增长机遇，进而传导至其核心零部件供应商。报告期内，公司作为国内领先的半导体设备精密金属零部件，凭借自身综合实力已获评国家级专精特新重点“小巨人”、国家级专精特新“小巨人”、江苏省先进级智能工厂、江苏省省级企业技术中心、江苏省专精特新中小企业等荣誉称号，且技术实力受到国内头部半导体设备厂商认可，预计随着本土半导体设备厂商的持续发展，公司有望同步受益。

（三）核心技术

公司在半导体设备精密零部件领域拥有深厚的技术积累和全面的工艺平台布局，核心技术涵盖了高精度机械制造、焊接、表面处理三大基础关键技术领域，并基于三大核心技术形成了复杂精密零部件工艺整合及检测技术等特色优势技术，技术体系全面。公司致力于半导体设备精密金属零部件的研发与制造，核心技术的先进性依赖于以深度工艺理解为基础、以系统化整合为路径的完整技术体系。该体系直接针对半导体制造设备在高温、高真空、强腐蚀及等离子体等极端复合工况下对零部件提出的多维严苛要求，需具备材料适配分析、复杂零部件结构及工艺路径设计到制造与检测的全流程能力。

具体来看，跨工艺的协同设计与整合能力至关重要，半导体关键零部件往往需要同时满足如高洁净、高密封、长期耐腐蚀及热机械稳定等多重目标，并需要结合具体性能要求进行工艺整合，例如，为保障腔体在强腐蚀环境中的长期可靠性，需施加厚层表面处理，但这可能引入应力影响密封面的精度；又如，在确保复杂结构零部件部件极致密封性的焊接过程中，必须同步解决焊接材料残留导致的洁净度风险。而公司通过自主掌握的精密机械加工、焊接、表面处理及工艺整合能力，能够进行协同设计与工艺优化，从而系统性地使得产品满足半导体设备的综合性能要求，确保产品在极端环境下的综合性能与可靠性。

公司已构建了零部件产品“设计-制造-验证”能力，从前期基于工况的材料选型、结构设计及工艺路线设计，到制造环节中针对特定问题的专用工装开发，直至最终依托于多项专用检测平台的严格验证，使得公司能够深入参与客户产品开发并提供高可靠性解决方案。公司以完整工艺体系、工艺设计、系统整合为特征的核心能力，构成了公司作为精密金属零部件供应商的核心优势，也是支撑公司持续服务先进工艺半导体设备零部件需求的技术基础，为公司的持续发展和市场竞争提供了技术支撑。上述核心技术的具体情况如下：

1、高精度机械制造

半导体设备金属零部件对加工精度要求极高，需要围绕精准的加工工艺路线和程序的开发、材料科学和材料力学与零件结构和加工参数的匹配、制造方式与产业模式的匹配以生产高精密的产品。精密金属零部件制造商需通过对机械制造精度和所加工材料的精准把控，满足客户半导体设备的功能性需求，以加工高精度的反应腔、匀气盘等零部件为例，尺寸精度的微小偏差都可能影响半导体设备的性能和晶圆制造的质量。经过长期的生产实践，发行人已针对半导体设备零部件机加工特点自主研发出包括复杂结构零件精密加工技术、微细孔精密制造技术及高光洁度表面制造技术等在内的多项高精度机械制造技术，并严格执行高洁净机加工过程管控工艺。

2、焊接工艺

焊接技术是半导体设备金属零部件制造的关键环节之一，对产品密封性、可靠性和寿命有关键影响。公司通过深入攻关焊接工艺、参数、材料及环境控制，着力实现焊缝区域的高洁净度与高结构完整性，以保障零部件在真空环境下的长期稳定运行，并为复

杂结构产品的量产提供核心技术支撑。公司焊接工艺的先进性主要体现在以下方面：

(1) 综合运用多项焊接工艺实现工艺能力整合：复杂结构精密零部件的制造通常需要综合运用多种焊接工艺整合，对焊接工艺把控及设计能力提出极高要求。公司掌握包括中温真空钎焊技术、高温真空钎焊技术、半导体级高洁净氩弧焊技术、电子束焊接在内的全面焊接工艺体系，并与国内领先的钎焊设备制造商合作开发专用装置，以匹配半导体金属零部件对焊接性能的严苛需求。

以复杂结构零部件多管式加热反射罩为例，其制造依赖于复合焊接工艺以实现关键性能与结构要求，公司该产品需将 400 余个铜与不锈钢子件通过 800 多条焊缝结合，并采用真空钎焊实现不同材质材料的高质量连接，制造过程涉及多种焊接方法的协同控制，对结构设计、加工配合、焊接参数及表面处理均提出系统性要求。针对高性能多通路流道匀气零部件，公司通过“工艺协同-分级焊接-密封强化”的实现路径，系统整合真空钎焊、电子束焊、自动轨道焊及手工氩弧焊等多种先进焊接工艺。在结构设计阶段即进行焊缝布局与工艺匹配规划，焊接过程中依据材料特性与密封等级要求，逐级实施高精度连接与气密成型。各工艺环节均对应严格的密封性检测标准，确保多路独立水/气路在复杂腔室结构中的长期可靠隔离，形成了覆盖工艺分析、工艺整合、焊接与检验的全流程高复杂度工艺体系。除综合运用多项焊接工艺外，在焊接过程中，仍需通过精确的尺寸与光洁度控制、完善的焊接过程防护及系统的焊后处理，在保障流道结构完整密封的同时，实现了内部洁净与性能可靠，从而满足关键部件对温度与压力的精准控制要求。以发行人七层真空钎焊结构气体分布盘为例，其需要对各个子件的焊接过程进行严格把控以满足产品多层状态下各个子件整合后焊缝洁净度要求：

(2) 基于焊接能力量产多款复杂结构零部件，深受客户认可：公司掌握包括中温、高温真空钎焊、电子束焊、激光焊等在内的多种先进焊接技术，基于全面的焊接工艺能力，尤其在真空钎焊领域积淀深厚，公司已成功量产冷盘、多管式加热反射罩、静电卡盘基体、气体分布盘等多款高难度复杂零部件，并获得客户的高度认可。该等零部件具备较大工艺难度及准入门槛，依赖高精度、高洁净度的焊接实现多子件集成，其焊缝质量直接关系到设备的密封性、洁净度与长期稳定性。凭借深厚的技术积累，公司能够早期介入客户研发，通过合作开发与焊接模拟件验证，快速将焊接工艺能力转化为满足高性能要求的终端产品，使得公司能够快速响应客户对复杂结构零部件的需求，成为本土设备厂商在复杂结构关键工艺零部件领域的首选合作伙伴之一。

3、表面处理工艺

表面处理对半导体设备金属零部件具有多维度关键作用，是保障其性能与可靠性的重要环节。一方面，表面处理能够提升零部件表面平整度、洁净度及耐腐蚀性，满足半导体制造对超高真空环境、无杂质污染的严苛要求；另一方面，可优化表面物理特性，如增强耐磨性以延长零部件使用寿命，改善导热或绝缘性能以适配温度精准控制需求。现阶段，公司已构建了多样化表面处理工艺能力体系以满足半导体设备金属零部件性能要求。

为满足刻蚀及薄膜沉积设备对零部件的严苛洁净度要求，公司建立了涵盖高洁净清洗与阳极氧化的表面处理体系，通过高标准的清洗工艺确保表面污染物有效控制；同时掌握多种阳极氧化工艺，可形成满足不同耐蚀与绝缘需求的膜层，与公司其他核心工艺协同保障产品性能。

4、复杂精密部件工艺整合及检测能力

托伦斯在复杂精密部件的工艺整合与检测领域具备突出竞争优势。公司可将复杂结构零部件拆解为多个子部件分步加工，并通过精密机械制造、焊接、表面处理等关键环节的整合优化，该核心能力源于长期技术积累与丰富项目实践，并依托公司自主研发设计的多类型工装，使其能够攻克多层结构、大截面焊接、复杂水路及气路设计等技术难点，成功量产冷盘、多管式加热反射罩、静电卡盘基体等复杂结构产品。检测能力方面，托伦斯构建了全面覆盖尺寸测量、元素成分、温度、流量、内部结构、电性能、洁净度、密封性等维度的综合检测体系，并建立多项检测工艺平台。

（四）研发水平

1、获得的主要奖项和荣誉

截至本上市保荐书签署日，公司或产品获得的主要荣誉、奖项情况如下：

序号	授予部门	荣誉资质	获奖年度
1	国家工业和信息化部	国家级专精特新重点“小巨人”	2025年
2	南通市工业和信息化局	创新型中小企业	2025年
3	江苏省工业和信息化厅	江苏省先进级智能工厂	2025年
4	江苏省工业和信息化厅	省级企业技术中心	2025年
5	北京北方华创微电子装备有限公司	2024年度战略合作伙伴奖	2025年

序号	授予部门	荣誉资质	获奖年度
6	上海稷以科技有限公司	最佳合作伙伴奖	2025年
7	江苏省知识产权局	知识产权贯标	2024年
8	江苏省科学技术厅	高新技术企业	2024年
9	江苏省民营科技企业协会	江苏省民营科技企业	2024年
10	江苏省工业和信息化厅	2024年江苏省智能示范工厂	2024年
11	南通市工业和信息化局	2024年度南通市首台（套）重大装备及关键部件	2024年
12	国家工业和信息化部	第六批国家专精特新小巨人	2024年
13	江苏省生产力促进中心	潜在独角兽	2024年
14	江苏省工业和信息化厅	企业上云五星	2024年
15	北京北方华创微电子装备有限公司	卓越合作伙伴奖	2024年
16	江苏省工业和信息化厅	企业上云四星	2023年
17	江苏省工业和信息化厅	江苏省级智能车间	2023年
18	江苏省工业和信息化厅	江苏省专精特新中小企业	2023年
19	中微公司	卓越合作及突出贡献奖	2022年
20	南通市工业和信息化局	市级企业技术中心	2022年
21	江苏省工业和信息化厅	企业上云三星	2022年
22	南通市科技局	瞪羚企业	2022年

2、在研项目情况

公司在对多款新型零部件进行研发工作，同时，公司亦对核心工序新技术进行研发以进一步巩固现有零部件制造技术的领先地位，并根据行业发展趋势不断拓展前沿技术的研发。截至2025年6月30日，公司正在从事的对目前或未来经营有重大影响的研究项目情况具体如下：

项目名称	研发进度情况	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域
薄膜及刻蚀设备高性能复合匀气盘精密制造工艺研发	研发阶段	实现匀气盘多阶孔结构工艺稳定性，应用专业焊接技术强化层间固定，优化刀具路径与加工参数以消除孔内毛刺；采用超高洁净清洗工艺提升洁净度等级，结合高精度检测保障尺寸及形位公差精度，形成标准化制造工艺	国内领先	半导体刻蚀及薄膜沉积设备气体分配系统
薄膜及刻蚀设备铝基加热器制造工艺研发	研发阶段	攻克不同材质材料热膨胀系数失配引发的焊接相关缺陷，实现加热器加热与冷却功能一体化集成；建立电-热综合性能测试与验证体系，保障加热	国内领先	半导体刻蚀及薄膜沉积设备气体分配系统

项目名称	研发进度情况	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域
		器长期工作的温度均匀性与功能稳定性，打破相关技术垄断		
刻蚀设备静电卡盘基体的精密机加焊接及表处的工艺开发	研发阶段	精确控制真空钎焊工艺参数与装配精度，实现高焊合率并消除微细流道相关工艺缺陷；引入精密研磨工艺解决高平面度表面质量问题，优化表面处理工艺降低介质渗漏概率，研制国产化样机	国内领先	半导体设备静电卡盘基体
高性能精密部件机械制造工艺优化研发	研发阶段	创新精密部件工艺链设计，引入真空环境去应力热处理及高低温循环处理等工艺，消除氧化风险并提前释放残余应力，保障零部件在严苛工况下的尺寸稳定性与长期可靠性，同时提升加工效率与制造水平	国内领先	精密机械制造工艺研发
刻蚀及薄膜沉积设备高性能精密腔体加工工艺研发	研发阶段	开发适用于大尺寸腔体的低应力精密加工工艺，创新表面处理技术，提高耐等离子体腐蚀性能，并结合仿真与智能优化，提升加工效率与一致性	国内领先	半导体刻蚀及薄膜沉积设备腔体
薄膜及刻蚀设备冷盘钎焊先进工艺研发	研发阶段	优化冷盘钎焊结构设计，攻克钎料溢流堵塞流道等工艺缺陷；开发专用钎焊工艺，提升冷盘工作表面温度均匀性与批次加工一致性，保障其温度管理性能的稳定可靠性	国内领先	半导体刻蚀及薄膜沉积设备温度控制系统
半导体设备核心内衬精密加工工艺研发	研发阶段	攻克薄壁零件加工变形及厚板零件氧化层性能一致性等技术难题，优化专用材料精密加工与表面处理工艺，显著提升半导体设备核心内衬的几何精度、尺寸稳定性及综合服役性能，实现国产化替代	国内领先	半导体刻蚀及薄膜沉积设备腔室内衬
气体管路异形精密折弯工艺研发	研发阶段	应用高精度数控弯管技术，攻克大管径管路折弯的褶皱、变形等技术难题，实现多角度、小半径、复杂空间走向气体管路的精确成型，满足半导体气体设备对管路形位精度与高洁净度的严苛要求	国内领先	半导体设备气体传输管路系统
电气控制柜及模组线束高端集成工艺研发	研发阶段	优化半导体设备电气控制柜及模组线束的集成方案与工艺规范，实现线缆标准化制作与模块化集成，建立完善的组装管控体系，满足半导体制造环境对电磁兼容性、信号完整性及长期可靠性的严苛要求	国内领先	半导体设备及工业自动化电气控制系统
半导体设备高耐电压有机酸阳极氧化先进工艺研发	研发阶段	系统研究有机酸体系相关工艺参数对阳极氧化膜微观结构与核心性能的影响规律，开发适配高压等离子体环境的高耐电压有机酸阳极氧化工艺，优化膜层均匀性、致密性及界面结合力	国内领先	半导体设备关键零部件表面处理
应用于薄膜沉积设备的不锈钢耐	研发阶段	系统研究电解液配方及电解抛光、钝化相关工艺参数对不锈钢耐蚀性的影	国内领先	薄膜沉积表面处理工艺

项目名称	研发进度情况	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域
腐蚀性能增强创新工艺研发		响机制，结合表层成分结构分析，开发薄膜沉积设备腔体用不锈钢的高性能表面处理工艺，提升其耐腐蚀能力与表面质量		
医疗设备精密零部件高端制造工艺研发	研发阶段	开展医疗设备精密零部件的专用材料优选、超精密加工工艺开发及特种表面处理技术研究，攻克复杂结构成型与高精度检测等技术难题，打造满足医疗领域高可靠性、生物相容性及精密性要求的关键零部件	国内领先	高端医疗设备核心精密零部件
气体管路特殊焊接工艺研发	研发阶段	针对短距离非标准件等特殊管路焊接需求，优化管路连接件结构与焊接工装夹具，攻克短距离轨道焊接的同轴度、形位及焊缝完整性等技术难题，实现高可靠性的特殊轨道焊接工艺，保障焊接件精度与稳定性	国内领先	半导体气体传输设备非标管路焊接
气柜模组组装与综合测试工艺研发	研发阶段	攻克传统气柜模组在复杂流道适配、热变形控制及密封性保障方面的工艺瓶颈；结合标准化模块化设计、专业测试技术，研发适配半导体装备的高气密性、低应力 GasBox 高端组装与综合测试体系，保障产品质量与性能稳定性，拓展业务品类	国内领先	半导体特气柜及系统组装模组
薄膜沉积设备喷嘴制造工艺研发	研发阶段	解决传统喷嘴薄膜均匀性欠佳、材料利用率较低及结构适配性不足等问题，通过专用材料优化与精密复合加工技术，实现喷嘴的高精度、长寿命及定制化制造，建立小试生产线，提升薄膜沉积工艺的稳定性与整体效率	国内领先	薄膜沉积设备材料沉积系统
高温钎焊金基焊料的工艺研发	研发阶段	突破传统金基焊料高温强度衰减、陶瓷与金属润湿性不足的技术瓶颈，通过多尺度钎料设计与工艺智能优化，研发超高温稳定的金基复合钎料，建立专业焊接制造体系，适配极端工况下的部件连接	国内领先	钎焊工艺研发升级
薄膜及刻蚀设备气体分布盘制造工艺研发	研发阶段	攻克气体分布盘焊接变形、腔室碎屑残留及高洁净度保障等工艺瓶颈，通过钎焊工艺优化与专用清洗技术创新，保障产品焊合率与洁净度，形成稳定可靠的标准化制造工艺	国内领先	半导体刻蚀及薄膜沉积设备气体分配系统
大型腔体的制造工艺研发	研发阶段	解决传统大型腔体分段制造的结构弱化、装配误差及生产效率偏低等问题，融合增材制造与精密加工技术，研发大型复杂腔体的高性能、轻量化制造工艺，形成相关技术规范	国内领先	精密机械制造工艺研发
薄膜及刻蚀设备不锈钢基体加热器制造工艺研发	研发阶段	攻克传统不锈钢基体加热器高温稳定性、热均匀性及耐腐蚀性等方面的技术瓶颈，通过多区加热结构设计与特	国内领先	薄膜沉积及刻蚀设备温度控制功能区

项目名称	研发进度情况	拟达到的目标	与行业技术水平的比较	主要应用领域
		种表面处理，提升加热器综合性能，满足半导体先进制程需求		
零部件生产快速切换装置的研发	研发阶段	突破传统生产换型中工装调整与参数重置耗时的瓶颈，通过模块化设计与高精度定位机构创新，研发高柔性快速切换装置，实现机外装夹，提升设备稼动率，适配多品种零部件的高效切换	国内领先	精密机械制造工艺研发
高耐腐蚀性高磷镍镀层的工艺研发	研发阶段	解决传统高磷镍镀层耐蚀性不足的问题，优化电化学沉积参数与添加剂体系，研发高性能高磷镍镀层工艺，形成场内自主制程，满足极端环境下零部件的表面防护需求	国内领先	表面处理工艺研发升级
不同金属高温钎焊的工艺研发	研发阶段	突破传统钎焊接头高温强度不足、残余应力较大的技术瓶颈，通过专用钎料设计、界面反应调控及工艺优化，实现不同材质金属在极端工况下的可靠连接，建立完善焊接制造体系	国内领先	钎焊工艺研发升级
半导体零部件喷涂工艺研发	研发阶段	攻克传统喷涂涂层孔隙率高、热应力匹配性差及洁净度不足等技术难题，通过等离子体调控与界面工艺优化，研发半导体零部件专用复合陶瓷涂层工艺，形成专业喷涂产线，提升零部件服役寿命与晶圆制程良率	国内领先	表面处理工艺研发升级
硬质阳极氧化特氟龙封孔工艺研发	研发阶段	解决传统封孔工艺在孔隙率、耐腐蚀性及耐磨性等方面的不足，通过特氟龙体系优化与封孔工艺创新，形成高性能封孔层，满足高端领域	国内领先	表面处理工艺研发升级

3、报告期研发费用占营业收入的比例

报告期内，公司研发费用及占营业收入比例情况如下：

单位：万元

项目	2025年1-6月	2024年度	2023年度	2022年度
研发费用	1,511.22	2,341.52	1,154.47	555.38
营业收入	37,344.41	61,005.34	29,058.13	28,321.68
研发投入占营业收入的比例	4.05%	3.84%	3.97%	1.96%

4、研发人员情况

单位：人

项目	2025年6月30日	2024年12月31日	2023年12月31日	2022年12月31日

研发人员数量	87	80	57	35
员工数量	925	762	526	461
占比	9.41%	10.50%	10.84%	7.59%

（五）主要经营和财务数据及指标

项目	2025年6月30日/2025年上半年度	2024年12月31日/2024年度	2023年12月31日/2023年度	2022年12月31日/2022年度
资产总额（万元）	136,543.59	112,640.11	68,715.17	40,029.39
归属于母公司所有者权益（万元）	84,434.83	77,657.32	43,006.75	8,551.00
资产负债率	38.16%	31.06%	37.41%	78.64%
营业收入（万元）	37,344.41	61,005.34	29,058.13	28,321.68
净利润（万元）	6,085.23	10,551.79	1,530.47	3,394.53
归属于母公司所有者的净利润（万元）	6,085.23	10,551.79	1,530.47	3,394.53
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）	5,955.94	10,105.42	1,373.07	3,477.62
基本每股收益（元）	0.44	0.81	0.20	0.57
稀释每股收益（元）	0.44	0.81	0.20	0.57
加权平均净资产收益率	7.54%	20.28%	5.63%	80.50%
经营活动产生的现金流量净额（万元）	5,918.13	5,592.44	-4,943.35	-7,798.29
现金分红（万元）	-	-	-	-
研发投入占营业收入的比例	4.05%	3.84%	3.97%	1.96%

注：

资产负债率=负债合计/资产总计

基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/发行在外的普通股加权平均数

稀释每股收益=稀释后归属于公司普通股股东的净利润/稀释后发行在外的普通股加权平均数

加权平均净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润/加权平均净资产

（六）发行人存在的主要风险

1、与发行人相关的风险

（1）技术风险

1) 无法跟随工艺制程演进及半导体设备更新迭代的风险

半导体设备是产业链上游的核心组成部分，具有高占比、高投入、高技术壁垒的特

点，在芯片制造中发挥着关键作用。随着芯片制程的不断升级，半导体设备和半导体设备精密零部件必须紧跟下游需求不断研发升级。目前晶圆制造和半导体设备已向更先进的工艺制程演进，对公司的研发能力不断提出更高要求。此外，对于同一代工艺制程，半导体设备企业也会不断升级产品，提高晶圆制造效率，公司须及时研发相匹配的精密零部件或对原有产品持续优化。

若公司产品研发不能及时满足客户工艺制程演进，不能紧跟客户产品的更新迭代，公司的行业地位和未来经营业绩将受到不利影响。

2) 技术人才流失与核心技术泄密的风险

随着市场需求的不断增长与行业竞争的日益激烈，半导体设备精密零部件行业对技术人才的需求不断提升，公司需长期维持技术人才充足、队伍稳定以保持市场竞争力。若无法持续为技术人才提供更具竞争力的薪酬待遇和发展平台，公司将面临技术人才流失的风险。

同时，随着半导体行业技术壁垒的不断提高，核心技术对于公司保持和提升竞争力至关重要，若因技术人才流失、员工工作疏漏、外界窃取等原因导致核心技术泄密的风险，则可能对公司的经营和发展造成不利影响。

(2) 经营风险

1) 客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户销售占主营业务收入比例分别为 94.78%、89.70%、93.44% 和 93.54%，客户集中度较高且较为稳定，主要原因为半导体行业技术和资本高度密集，导致下游设备企业、晶圆代工企业呈现数量少、规模大的特征。

若公司主要客户生产经营情况恶化、或由于半导体行业景气度下降导致行业下游资本性支出下降，进而导致主要客户向公司下达的订单数量下降，或下游以及终端客户因技术迭代或供应链、产能等因素推迟订单交付，则可能对公司的业绩稳定性产生影响。此外，如果公司无法维护与现有主要客户的合作关系与合作规模、无法有效开拓新客户资源并转化为收入，亦将可能对公司经营业绩产生不利影响。

2) 对大客户依赖的风险

报告期内，公司对第一大客户北方华创的销售收入分别为 12,888.51 万元、12,649.51

万元、31,583.44 万元和 16,517.56 万元，占各期主营业务收入的比例分别为 46.18%、44.06%、52.11%和 44.60%，对单一客户构成重大依赖，公司预计在未来一定时期内仍将存在对北方华创销售收入占比较高的情形。除北方华创外，中微公司也是发行人报告期内主要客户之一，各期形成的收入规模及占主营业务收入比例分别为 30.33%、30.23%、31.40%、39.13%，亦相对较高。

未来若北方华创、中微公司的经营策略或产品市场需求发生较大不利变化，或公司与北方华创、中微公司的合作关系被其他供应商替代，或由于公司自身原因导致公司无法与北方华创、中微公司保持稳定的合作关系，将对公司经营产生重大不利影响。

3) 新产品及新工艺开发风险

公司成为客户的合格供应商，一般需要完成质量体系认证、特种工艺制程认证、首件试制等环节，方可具备为客户量产特定首件的资格。具体来说，公司接收到客户的新品需求时，首先评估现有工艺是否能够满足客户的主要性能要求，并综合考虑工艺升级难度、开发成本及预期订单规模等因素，最终决定是否承接该新品项目，在决定承接后，公司将启动样块或样件开发测试，并进一步进行首件试制再交付客户，若客户认可且有需求则将加大采购数量，进入批量下单生产阶段。

若新产品、新工艺开发或首件试制失败，或首件在技术、性能和成本等方面不具备竞争优势、或未能优先选择具有较好市场前景、高附加值的首件产品、或搭配公司首件的客户产品未能获得足够的晶圆厂订单，均可能对公司持续经营产生不利影响。

4) 知识产权的风险

半导体设备行业是典型的技术密集型行业，为了保持技术优势和竞争力，防止技术外泄风险，已掌握先进技术的半导体设备企业通常会通过申请专利等方式设置较高的进入壁垒。公司存在与竞争对手产生知识产权纠纷的风险，届时可能需要通过法律诉讼等方式维护自身权益，由此可能需承担较高的法律和经济成本，将对公司的生产经营造成不利影响。同时，专利、商标等知识产权保护与侵权风险可能会随着公司产品线的不断丰富而增加。

截至本上市保荐书出具日，公司累计拥有 69 项授权发明专利及实用新型专利。如果将来出现专利申请失败、知识产权遭到第三方侵害盗用或者公司核心技术泄露等情况，将可能导致公司专利被侵权或者恶意抢注致使公司商业利益受到损害，进而对公司生产

经营、持续发展造成不利影响的情况。

(3) 财务风险

1) 经营业绩持续性风险

报告期内，公司产品主要应用于半导体领域，产品销售与下游半导体行业景气度相关。自 2023 年下半年以来，在国内半导体设备国产化进程加速、半导体制造厂商扩产的共同驱动下，半导体零部件行业进入显著上行周期，公司营业收入伴随行业景气度同步实现稳健增长。最近三年，公司营业收入年化增长率为 46.77%，其中近一年营业收入同比增长 109.94%。

然而，若未来国家产业政策发生调整，或半导体行业发展不及预期导致行业景气度下降，下游半导体制造客户的投产或产线更新意愿将可能减弱，从而引致半导体设备销售量减少，对公司经营业绩造成不利影响，导致公司业绩增速放缓甚至出现下滑。此外，公司本次募投项目虽有望带来收入增长，但在项目达产前，因新增折旧摊销与期间费用，公司可能面临净利润增速低于营业收入增速的情况，致使公司业绩在短期内承受增速放缓甚至下行的压力。

2) 存货跌价风险

报告期各期末，公司存货账面价值分别为 8,160.35 万元、9,794.13 万元、12,384.13 万元和 17,262.69 万元，占各期末流动资产的比例分别为 33.91%、20.32%、15.00% 和 19.00%，公司存货周转率分别为 2.68、2.16、3.29 和 1.52（未年化）。公司库存商品规模持续增加，主要系经营规模持续扩张，为满足客户的交付需求所致。

未来若公司无法对存货进行有效管理，加快销售速度，发生客户需求变更等不利变化，导致公司存货出现跌价、积压、滞销情况，公司将出现存货进一步减值而计提跌价的风险，进而对财务状况产生不利影响。

3) 应收账款无法收回风险

报告期各期末，发行人应收账款余额分别为 5,218.61 万元、14,382.81 万元、19,749.69 万元和 26,851.59 万元，占当期营业收入的比例分别为 18.43%、49.50%、32.37% 和 71.90%；公司应收账款周转率分别为 3.72、2.96、3.57 和 1.60（未年化）。随着公司营业收入规模提升，公司应收账款余额提升较快。

公司客户主要为国内半导体设备龙头厂商，商业信用良好，但未来若主要客户因经营情况或商业信用发生重大不利变化，以及公司对信用风险管控不当，则可能导致应收账款不能及时收回，从而影响公司流动资金的周转和经营业绩。

4) 税收优惠及政府补助不确定性风险

报告期内，公司享受高新技术企业税收优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税，上述高新技术企业认定持续至 2026 年。若公司高新技术证书到期未通过复审或者未来国家取消或变更税收优惠政策，可能导致公司不再享受上述优惠税率，从而对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

报告期内，公司确认为当期损益的政府补助分别为 66.39 万元、96.48 万元、338.32 万元和 78.80 万元。若未来政策环境发生变化，或公司不再符合相关的认定或鼓励条件，将导致公司无法持续获得政府补助，从而对公司业绩水平造成一定的影响。

5) 关联交易风险

发行人报告期内主要的关联采购交易包括向实控人近亲属控制或共同控制的企业南通高米、上海高郇采购外协加工服务。报告期内，公司对关联方采购分别为 887.89 万元、1,004.57 万元、2,366.82 万元和 1,796.70 万元，占当期营业成本的比例分别为 4.52%、4.50%、5.53%和 6.89%，但若公司内部控制有效性不足，运作不够规范，主要关联方可能通过关联交易对公司及股东造成影响，存在损害发行人和投资者利益的风险。

(4) 管理及内控风险

1) 规模增长带来的管理风险

公司产品具有多品种、小批量、定制化的特点，制造模式对公司的管理能力要求较高。报告期内，公司生产经营规模持续增长、组织架构日益庞大，管理、技术和生产人员数量持续增加等均对公司的管理层和内部管理水平提出了更高的要求。如公司管理能力不能及时匹配公司经营规模增长，将影响公司的生产经营和长远发展。

2、与行业相关的风险

(1) 行业周期性风险

公司所处半导体设备零部件行业的周期性与半导体行业的周期性密切相关。半导体行业受宏观经济环境、技术创新周期及市场供需波动等因素影响，呈现周期性波动。作

为半导体产业上游，半导体设备零部件行业的景气度直接受半导体行业资本性支出的影响，因此也随之呈现周期性波动。

报告期内，公司受益于我国半导体制造产业中存储厂和逻辑芯片制程升级扩产的带动，以及半导体设备国产化率提升的积极影响，业绩呈现增长趋势。然而，若未来宏观经济发生周期性波动，导致计算机、消费电子、网络通信、汽车电子以及物联网等终端消费市场需求下降，将可能使得半导体设备厂商与晶圆厂面临产能利用率下降因此削减资本性支出，进而对公司的业绩产生不利影响。

同时，在半导体行业景气度提升的周期，公司必须保证充足的产能以满足客户需求。若公司未能及时应对客户需求的快速增长，或对需求增长的持续时间及幅度判断失误，则可能导致公司失去现有或潜在客户，进而对公司的业绩产生不利影响。

(2) 市场竞争加剧风险

半导体行业的快速发展，吸引了越来越多的市场参与者积极开展相关领域的投资，加剧了行业的竞争。目前，半导体设备精密零部件市场主要由美国、日本和中国台湾地区的企业占据主导地位，公司与国际领先企业之间在市场竞争力、市场占有率上仍然存在一定的差距。同时，随着半导体领域国产替代进程的不断加速，未来可能将有更多国产零部件厂商加入市场竞争。

以公司为代表的半导体设备精密零部件厂商必须持续增强研发能力、客户资源、产品质量等方面竞争优势，才能形成一定的竞争壁垒。但若未来公司在研发设计、产品迭代等方面不能持续保持优势，随着竞争的加剧，将会对公司的经营产生不利影响。

(3) 劳动力短缺及用工成本上升风险

目前公司生产制造环节需要大量的生产操作人员，人力成本对公司营运成本具有一定的影响。随着我国经济结构转型调整、人口老龄化加速、城市生活成本提高，人口红利逐渐减弱，劳动力供给出现回落，公司存在劳动用工短缺及人力成本上升的风险。若未来公司的员工工资水平快速上涨，以及与员工薪酬相关的其他福利、社会保障等支出持续提高，将对公司的盈利能力造成不利影响。

(4) 贸易摩擦风险

集成电路行业主要包括装备制造、制造材料、芯片制造三大领域，近年来，随着美

国芯片法案等贸易政策不断加码，地缘半导体摩擦持续升温，集成电路行业已逐步成为重点关注领域。公司所从事的业务位于半导体装备制造的上游，主要使用基础金属大宗商品制造半导体装备用精密零部件，主要客户为国内半导体设备公司，但也存在最终客户为美国客户的情形。报告期各期，发行人向境外地区（不含保税区）的销售收入占主营业务收入的比例分别为 18.25%、14.37%、5.78%和 7.07%。

销售端来说，2025 年以来，中美贸易摩擦加剧，美国已分别于 2 月 4 日和 3 月 4 日对所有进入美国的原产于中国的商品两次加征 10%关税，并于 2025 年 4 月起，陆续增加了对进口自中国的商品的对等关税。随着中美双方的关税战加剧，未来中美之间的贸易关系存在进一步恶化的可能性，可能会对我国终端芯片制造的投资强度和投资周期产生不利影响，进而传导至国产装备制造领域。公司客户可能面临与上下游合作伙伴继续合作受限、供应链稳定性受到影响、终端订单需求下降等风险，从而对公司经营发展产生一定的不利影响。

同时，从采购端来说，美国商务部产业安全局于 2025 年 1 月修订了《出口管制条例》，限制 HBM、EDA 软件、更多类型的半导体设备等高算力芯片的配套产业出口，并强化了对晶圆代工企业和封装测试企业的审查要求，以限制先进制程计算芯片出口。报告期内，上述贸易政策的变化均未对发行人的产品出口和原材料进口产生重大不利影响。

未来如果中美贸易摩擦持续加深，进一步加征关税，或地缘政治局势恶化，相关国家对发行人的出口产品加征高额关税或实施反倾销、反补贴等政策，或对发行人的进口原材料实施出口管制等政策，可能导致公司的产品出口或部分原材料进口产生一定的不利影响，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

3、其他风险

(1) 募集资金投资项目实施风险

本次募集资金将投资于托伦斯精密零部件制造及研发基地项目，并补充流动资金，需要购置较多研发设备、生产设备、测试设备等。报告期各期，公司产能利用率分别为 79.97%、77.50%、97.57%和 90.45%，产能利用率已接近满产，本次募投项目系发行人提高产能的重要投资项目，如果在项目实施过程中建设进度、投资成本、宏观经济形势、相关产业政策等客观条件发生较大不利变化，则本次募集资金投资项目是否能够按时实

施、涉及研发项目实施效果是否符合预期、募投项目产能利用情况等将存在不确定性，从而影响公司业绩，为公司的生产经营和未来发展带来一定的风险。同时，若行业需求出现较大波动，如下游以及终端客户因技术迭代或供应链、产能等因素推迟相应零部件需求、以及发行人募集资金投资项目方向涌入新的竞争者，则存在新增产能消化较慢的风险，进而对公司经营业绩产生不利影响。

（2）汇率波动风险

报告期内，公司主营业务收入中销售至保税区及其他境外地区的境外收入占比分别为 40.74%、31.42%、16.82% 和 29.31%，且主要以美元结算。报告期内公司汇兑损益分别为-367.57 万元、44.27 万元、-190.93 万元和 97.14 万元。报告期内，公司出口产品及进口原材料主要以美元计价结算，未来若人民币与美元汇率发生大幅波动以及未来公司经营规模持续扩大后，以美元结算的销售额和采购额进一步增长，对公司出口产品和进口原材料产生较大影响，引起公司营业收入和营业成本的波动，进而对公司未来的净利润造成一定的影响。

（3）发行相关的风险

1) 发行认购不足的风险

公司及主承销商在股票发行过程中将积极推进投资者推介工作，扩大与投资者接触范围，加强与投资者沟通，紧密跟踪投资者动态。但投资者投资意向取决于股票供需关系、同时期市场环境以及投资者心理预期等因素，本次发行可能出现网下投资者股票申购数量未能满足《上市规则》等相关法律法规的要求的情形，导致发行失败。

2) 发行后即期回报摊薄的风险

本次募集资金到位后，公司净资产规模将显著增长，而募集资金投资项目有一定的建设周期，所投资项目建设期内不产生直接的经济效益。因此，公司募集资金到位后，短期内存在净资产收益率下降的情形。若本次发行募集资金投资项目实现效益不及预期，将可能导致公司的每股收益和净资产收益率被摊薄，从而降低公司的股东回报。

3) 预计市值无法达到上市标准的风险

本次发行的发行结果将受到证券市场整体情况、公司业绩、公司发展前景及投资者对本次发行的认可程度等多种内外部因素影响。若半导体行业整体表现及公司经营

业绩大幅低于预期，或因资本市场行情发生剧烈波动或投资者对公司估值低于预期等原因，导致公司本次发行价格偏低，使得本次发行时公司预计市值未能达到 15 亿元，则可能导致发行失败的风险。

二、申请上市股票的发行情况

股票种类	人民币普通股（A 股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行股数及其占发行后已发行股份总数的比例	本次拟公开发行股份不超过 46,368,423 股（不考虑超额配售选择权），占发行后总股本的比例不低于 25%。 公司本次发行不涉及股东公开发售股份
每股发行价格	人民币【】元
发行方式	本次发行采用网下向询价对象配售发行与网上申购定价发行相结合的方式，或者中国证监会、深圳证券交易所要求或认可的其他方式
发行对象	符合国家法律法规和监管机构规定条件的询价对象以及已开立深圳证券交易所股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（法律、法规及深圳证券交易所等业务规则禁止购买者除外）
承销方式	余额包销
拟申请上市证券交易所	深交所创业板

三、项目保荐代表人、协办人及项目组其他成员情况

（一）项目保荐代表人保荐业务主要执业情况

王帅：于 2018 年取得保荐代表人资格，曾经担任星环科技科创板 IPO 项目的保荐代表人，曾负责或参与执行立功科技创业板 IPO、诚瑞光学科创板 IPO、全筑股份主板 IPO、新奥股份配股、福星股份非公开发行、晶瑞股份发行股份购买资产并配套募集资金、内蒙君正重大资产重组等项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

王竹亭：于 2020 年取得保荐代表人资格，曾经担任东微半导体科创板 IPO 项目的保荐代表人，在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

（二）项目协办人保荐业务主要执业情况

项目协办人：梁劲，于 2013 年取得证券从业资格，曾经参与/执行瑞泰新材创业板 IPO、锡南科技创业板 IPO、亚士创能主板 IPO、太平鸟主板 IPO、维远化学主板 IPO、

上海电力定向增发、利民股份公开发行可转债、会畅通讯重大资产重组等项目。

（三）项目组其他人员情况

项目组其他成员：吴迪、张莉、冯进军、占海伟、孟竹、王鑫、徐一睿、花月、袁萌桥。

（四）联系地址、电话和其他通讯方式

保荐机构：	中国国际金融股份有限公司
法定代表人：	陈亮
住所：	北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层
联系电话：	010-65051166
传真：	010-65051156
联系人：	王帅、王竹亭

四、保荐机构与发行人之间的关联关系

1、本机构自身及本机构下属子公司持有或通过参与本次发行战略配售持有发行人或其实际控制人、重要关联方股份的情况：

中金公司将按照深交所的相关规定确定是否安排相关子公司参与本次发行战略配售。如涉及参与战略配售，中金公司及其相关子公司后续将按照要求进一步明确参与本次发行战略配售的具体方案，并按规定向深交所提交相关文件并公告。

上述情形不影响保荐机构履行保荐职责的独立性，本机构与发行人之间不存在利益冲突。本机构担任发行人保荐机构符合《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》关于保荐机构独立性的要求。

截至2025年6月30日，中金公司及控股股东、实际控制人、重要关联方持有发行人股份情况如下：

中金公司全资子公司中金资本运营有限公司担任执行事务合伙人的中金启融（厦门）股权投资基金合伙企业（有限合伙）通过珠海金镒铭股权投资基金合伙企业（有限合伙）间接持有发行人0.1068%股份。

北京市科技创新基金（有限合伙）通过中电科核心技术研发股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）及北京集成电路装备产业投资并购基金（有限合伙）两个主体合

计间接持有发行人 0.35% 股份。中金公司全资子公司中金资本运营有限公司控股的北京科技创新投资管理有限公司为北京市科技创新基金（有限合伙）的执行事务合伙人并持有 1% 的出资份额，中金公司全资子公司中金浦成投资有限公司持有北京市科技创新基金（有限合伙）3.5237% 的出资份额。

除上述情况外，中金公司及其控股股东、实际控制人、重要关联方不存在持有发行人股份的情况。

2、发行人或其实际控制人、重要关联方不存在持有本机构及本机构下属子公司股份的情况。

3、本机构的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员，不存在持有发行人或其实际控制人及重要关联方股份，以及在发行人或其实际控制人及重要关联方任职的情况。

4、中金公司控股股东为中央汇金投资有限责任公司（以下简称“中央汇金”或“上级股东单位”），截至 2025 年 6 月 30 日，中央汇金直接持有中金公司约 40.11% 的股份，同时，中央汇金的下属子公司中国建银投资有限责任公司、建投投资有限责任公司、中国投资咨询有限责任公司共持有中金公司约 0.06% 的股份。中央汇金为中国投资有限责任公司的全资子公司，中央汇金根据国务院授权，对国有重点金融企业进行股权投资，以出资额为限代表国家依法对国有重点金融企业行使出资人权利和履行出资人义务，实现国有金融资产保值增值。中央汇金不开展其他任何商业性经营活动，不干预其控股的国有重点金融企业的日常经营活动。根据发行人提供的资料及公开信息资料显示，中金公司上级股东单位与发行人或其实际控制人、重要关联方之间不存在相互持股的情况，中金公司上级股东单位与发行人实际控制人、重要关联方之间不存在相互提供担保或融资的情况。

5、本机构与发行人之间不存在其他关联关系。

综上所述，本机构依据相关法律法规和公司章程，独立公正地履行保荐职责。

五、保荐机构承诺事项

（一）本机构已按照法律法规和中国证监会及深交所的相关规定，对发行人及其实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，充分了解发行人经营状况及其面临的风险和问题，履行了相应的内部审核程序。

本机构同意推荐发行人本次证券发行上市，相关结论具备相应的保荐工作底稿支持，并据此出具本上市保荐书。

(二) 保荐机构自愿接受深交所的自律监管。

六、本次发行履行了必要的决策程序

经核查，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》及中国证监会、深交所规定的决策程序，具体如下：

(一) 董事会决策程序

发行人于 2025 年 5 月 28 日召开第一届董事会第十次会议，审议并通过本次发行及上市的议案，审议通过了《关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》《关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票所募集资金投资项目可行性的议案》《关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案》《关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》等与本次发行上市相关的议案，对本次股票发行的具体方案、本次募集资金使用的可行性以及其他必须明确的事项作出了决议，并提请股东大会审议。

(二) 股东会决策程序

发行人于 2025 年 6 月 13 日召开 2025 年第三次临时股东会，审议通过了《关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司申请首次公开发行股票并在创业板上市方案的议案》《关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票所募集资金投资项目可行性的议案》《关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票前滚存利润归属的议案》《关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年股东分红回报规划的议案》等与本次发行上市相关的议案，对本次发行股票的种类和数量、发行对象、定价方式、募集资金用途、发行前滚存利润的分配方案、决议的有效期、对董事会办理本次发行具体事宜的授权以及其他必须明确的事项作出了决议。

综上，保荐机构认为，发行人已就本次证券发行履行了《公司法》《证券法》以及中国证监会、深交所规定的决策程序。

七、针对发行人是否符合创业板定位要求及国家产业政策的核查情况

保荐机构通过访谈发行人管理层，审阅研发项目资料及相关技术成果文件，查阅产品先进性说明及所获荣誉资质，复核会计师事务所出具的《审计报告》，审阅发行人营业执照、行业研究报告、《国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）》及产业政策文件等多种方式，对发行人是否符合创业板定位及国家产业政策要求进行了审慎核查。

（一）发行人具备创新、创造、创意特征

1、公司具备技术创新及产品创新特征

报告期内，公司以从事工艺难度大、质量要求高的半导体精密零部件以及激光设备零部件业务为主，各期主营业务收入占比分别为 98.54%、98.80%、99.35% 及 99.17%。公司产品系国家战略发展方面具有重要性的半导体设备零部件，半导体设备零部件是指在材料、结构、工艺、品质、精度、可靠性及稳定性等性能方面达到了半导体设备及技术要求的零部件，作为半导体设备的重要组成部分，零部件的质量、性能和精度优劣直接决定了半导体设备的可靠性和稳定性，是半导体设备产业中最为重要的环节之一。

公司的主营业务面向集成电路设备这一国家经济发展的重要领域。一方面，公司的机械类精密零部件是集成电路产业链上游的关键环节，对近年来国内集成电路设备及集成电路产业的综合发展具有重要意义，一是在半导体设备企业向更先进制程节点的研发和量产过程中发挥了重要的配套保障作用，一定程度上协助提升了研发效率和工艺进步速度，共同构建了国内集成电路完整产业链；二是帮助本土设备厂商构建了机械类精密零部件的研发、制造、售后服务体系，紧跟设备厂商设备设计需求布局工艺及产品研发，设备厂商可根据自身需求定制化采购关键零部件产品而非依照境外厂商标准件性能进行设备设计，有助于构建更为安全并自主可控的机械类精密零部件供应体系。

另一方面，公司致力发展精密加工、焊接、表面处理等核心技术，并在焊接工艺上形成了领先优势，助力了静电卡盘基体、多管式加热反射罩等关键零部件的国产化率提升，工艺及产品的积淀为我国应对先进工艺半导体设备零部件“卡脖子”难题提供支持。

2、公司通过半导体设备关键工艺零部件创造国产化替代机遇

公司产品则主要面向北方华创、中微公司等半导体设备客户，致力于帮助该等半导体设备客户实现制程突破及国产化替代。公司基于多年的研发投入、工艺及技术积累，形成了多项具有自主知识产权核心技术的机械类精密零部件制造工艺及产品，目前已成

为北方华创、中微公司等国内半导体设备客户的金属零部件的第一梯队核心供应商之一，也正是在公司金属关键工艺零部件的参与下，以北方华创、中微公司为代表的国内半导体设备企业在刻蚀、薄膜沉积等领域实现了突破，在营收规模上取得了良好发展。

3、公司伴随半导体设备客户成长，凭借新创意持续布局新产品覆盖更多半导体设备类型，致力于打造平台化零部件产品体系

随着半导体设备国产化率持续提升，以北方华创、中微公司为代表的国内半导体设备企业迎来良好发展机遇，将同步带动上游国产金属零部件产业的成长。公司作为国内半导体关键设备的金属零部件重要供应商，凭借扎实的技术实力和量产保障能力，已深度嵌入客户的供应链体系，具备参与国际竞争的能力，并将持续受益于半导体设备国产化进程。

公司依托在精密零部件制造领域长期积累的技术底蕴与工程经验，持续拓宽产品矩阵、拓展应用场景。一方面，公司紧密围绕半导体设备客户的供应链需求开展协同研发与产品导入，例如针对去胶及热处理设备所开发的关键工艺零部件已实现批量供应，助力客户完善自主可控的供应链布局，同时也丰富了公司产品所覆盖的设备类型。另一方面，公司积极进行自主技术开发，布局化学机械抛光、热处理设备等更多半导体设备品类的关键工艺零部件，进一步延伸产品链条、强化平台化供应能力。

在客户拓展方面，公司除持续深化与北方华创、中微公司等客户的合作外，产品也已成功导入宸微科技、稷以科技、博智航、无锡尚积等重要战略客户，并在激光设备领域与国际主流厂商 Lumentum 保持了长期稳定的合作关系，客户结构不断丰富、合作生态持续巩固。

公司致力于成长为我国具有综合竞争力的平台型金属零部件企业，未来将通过持续的技术创新、产品优化与市场开拓，覆盖更多类型的半导体设备及高端制造领域，为推动我国半导体设备关键零部件的自主可控与产业升级贡献力量。

（二）发行人所处行业市场前景广阔，具有高成长性

伴随全球半导体产业向国内持续转移，以及国内半导体设备自主可控需求的迫切提升，中国半导体设备市场快速增长。根据 SEMI 数据，2024 年国内半导体设备销售额达 495.5 亿美元，同比增长 35%，连续五年成为全球最大半导体设备市场。在半导体设备零部件的国产化进程中，金属机械类零部件作为设备关键组成部分，2024 年国内市

场规模约 30.97 亿美元，其预计深度受益于国内半导体设备国产化率提升，市场空间广阔。

半导体设备金属零部件行业属于技术密集型领域，涉及材料科学、精密加工、表面处理等多学科交叉技术，产品研发难度大、技术门槛高。在半导体制造工艺中，无论是复杂晶体管结构制造，还是 3D NAND 闪存的高精度垂直堆叠工艺，都对金属零部件的性能和质量提出了极高要求。从产品研发到通过客户验证进入量产阶段，平均周期长达数年，且验证成本高昂，这使得新进入者面临巨大挑战，行业形成较高的技术和市场壁垒，竞争格局相对集中。在产业链中，零部件厂商与半导体设备企业形成紧密的依存关系。零部件厂商需要深入了解设备厂商在先进技术应用中的技术需求，通过持续研发投入提升产品性能；而设备厂商则依赖零部件厂商提供稳定、优质的零部件供应，以保障设备性能和生产效率。双方通过长期合作建立信任关系，在技术研发、产品迭代等方面开展深度协作，共同推动半导体设备行业发展。

公司深耕国内半导体设备精密零部件制造领域，经过多年的沉淀，积累了丰富的客户资源，覆盖了包括北方华创、中微公司、宸微科技、稷以科技、博智航、无锡尚积等国产半导体设备企业及战略客户，深度参与客户多款先进设备的研发、定型和迭代升级，也与国际知名厂商 Lumentum 在激光设备领域保持长期合作。半导体设备零部件工艺难度大、精度要求高、技术门槛高，设备厂商往往不会轻易更换核心供应商，公司产品切入设备厂商供应链后便能持续产生先发优势，产品在客户端的市场份额占比持续提升，同时客户进行新产品开发时也更倾向于和公司进行技术合作及验证。公司明确了陪伴国内半导体设备厂商成长的经营理念，在半导体设备自主可控的国产化浪潮中具有先发优势，未来伴随国产半导体设备零部件需求量的提升，公司的业绩预计将随之增长成长确定性较强。

综上，发行人具备较强的成长性。

（三）发行人主营业务符合国家产业政策

根据《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017），公司属于“C34 通用设备制造业”中的“C3484 机械零部件加工”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司业务属于“2.1.5 智能关键基础零部件制造”。公司不属于《深圳证券交易所创业板企业发行上市申报及推荐暂行规定》中明确禁止或原则上不支持上市的行业。

近年来，国家密集出台多项政策支持集成电路产业发展，在《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》中明确将集成电路装备及其关键零部件列为重点发展方向。国家发改委《产业结构调整指导目录（2024 年本）》也将“集成电路装备及关键零部件制造”列入鼓励类目录。发行人主营业务聚焦半导体设备精密金属零部件的研发与制造，高度契合国家推动高端装备制造产业创新、实现关键技术自主可控的战略部署，符合国家产业政策导向。

综上，保荐机构认为，发行人产品与技术具有明显的创新特征，所处行业成长性突出，主营业务符合国家产业政策要求，符合创业板定位。

八、保荐机构关于发行人是否符合《创业板上市规则》规定的上市条件的逐项说明

本保荐机构依据《创业板上市规则》相关规定，对发行人是否符合上市条件进行了逐项核查，认为发行人符合《创业板上市规则》规定的首次公开发行股票上市条件。具体情况如下：

（一）发行人符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条之“（一）符合中国证监会规定的发行条件”规定

根据《关于托伦斯精密制造（江苏）股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的发行保荐书》之“第四节 本机构对本次证券发行的推荐意见”之“四、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件”和“五、本次证券发行符合《首发办法》规定的发行条件”，发行人符合《证券法》《首发办法》规定的公开发行股票的条件，符合中国证监会规定的发行条件，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第（一）项的规定。

（二）发行人符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条之“（二）发行后股本总额不低于人民币 3000 万元”规定

经核查，发行人本次发行前股本总额为 139,105,269 元，本次拟发行股份不超过 46,368,423 股（含本数，不含采用超额配售选择权发行的股票数量），发行后股本总额不低于人民币 3,000 万元，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第（二）项的规定。

（三）发行人符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条之“（三）公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上；公司股本总额超过人民币 4 亿元的，公开发行股份的比例为 10%以上”规定

经核查，本次拟发行股份不超过 46,368,423 股（含本数，不含采用超额配售选择权发行的股票数量），发行后公司股本总额不超过人民币 185,473,692 股（行使超额配售选择权之前），公开发行的股份达到公司股份总数的 25%以上，符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条第（三）项的规定。

（四）发行人符合《创业板上市规则》第 2.1.2 条之“（四）市值及财务指标符合本规则规定的标准”规定

发行人选择依据《上市规则》第 2.1.2 条“（二）预计市值不低于 15 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于 4 亿元”的市值及财务指标申请上市。

发行人 2024 年度经审计的营业收入为 61,005.34 万元，扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润分别为 10,105.42 万元，因此公司最近一年净利润为正且营业收入不低于 4 亿元。结合发行人最近一次增资对应的估值情况以及参考公司 2024 年度经营业绩及行业平均市盈率对公司市场价值的预估结果，预计发行人发行后总市值不低于人民币 15 亿元，满足前述上市标准。

（五）发行人符合《创业板上市规则》第 2.1.1 条之“（五）深圳证券交易所规定的其他上市条件”规定

经核查，发行人符合深交所规定的其他上市条件。

九、对发行人证券上市后持续督导工作的具体安排

事项	安排
（一）持续督导事项	在本次发行的股票上市当年剩余时间及其后 3 个完整会计年度对发行人进行持续督导。
1、督导发行人有效执行并完善防止实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度	1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止实际控制人、其他关联方违规占用发行人资源的制度； 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。
2、督导发行人有效执行并完善防止其董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度	1、督导发行人有效执行并进一步完善已有的防止董事、监事、高级管理人员利用职务之便损害发行人利益的内控制度； 2、与发行人建立经常性沟通机制，持续关注发行人上述制度的执行情况及履行信息披露义务的情况。

事项	安排
3、督导发行人有效执行并完善保障关联交易公允性和合规性的制度，并对关联交易发表意见	1、督导发行人有效执行并进一步完善《公司章程》《关联交易管理制度》等保障关联交易公允性和合规性的制度，履行有关关联交易的信息披露制度； 2、督导发行人及时向保荐机构通报将进行的重大关联交易情况，并对关联交易发表意见。
4、督导发行人履行信息披露的义务，审阅信息披露文件及向中国证监会、证券交易所提交的其他文件	1、与发行人建立经常性信息沟通机制； 2、督促发行人负责信息披露的人员学习有关信息披露的规定。
5、持续关注发行人募集资金的专户存储、使用、投资项目的实施等承诺事项	1、督导发行人执行已制定的《募集资金管理制度》等制度，保证募集资金的安全性和专用性； 2、持续关注发行人募集资金的专户储存、投资项目的实施等承诺事项； 3、如发行人拟变更募集资金及投资项目等承诺事项，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。
6、持续关注发行人为他人提供担保等事项，并发表意见	1、督导发行人执行已制定的《对外担保管理制度》等制度，规范对外担保行为； 2、持续关注发行人为他人提供担保等事项； 3、如发行人拟为他人提供担保，保荐机构要求发行人通知或咨询保荐机构，并督导其履行相关信息披露义务。
7、持续关注发行人经营环境和业务状况、股权变动和管理状况、市场营销、核心技术以及财务状况	与发行人建立经常性信息沟通机制，及时获取发行人的相关信息。
8、对发行人存在的可能严重影响公司或者投资者合法权益的事项开展专项核查，并出具现场核查报告	针对可能严重影响发行人或投资者合法权益的事项，对发行人进行现场检查，并督导发行人即刻汇报相关工作。
(二) 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定	1、指派保荐代表人或其他保荐机构工作人员或保荐机构聘请的第三方机构列席发行人的股东大会、董事会和监事会（ 现已取消 ）会议，对上述会议的召开议程或会议议题发表独立的专业意见； 2、指派保荐代表人或保荐机构其他工作人员或聘请的第三方机构定期对发行人进行实地专项核查。
(三) 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定	1、发行人已承诺全力支持、配合保荐机构做好持续督导工作，为保荐机构的保荐工作提供必要的条件和便利，及时、全面提供保荐机构开展保荐工作、发表独立意见所需的文件和资料，并确保公司高管人员尽力协助保荐机构进行持续督导； 2、发行人应聘请律师事务所和其他证券服务机构并督促其协助保荐机构在持续督导期间做好保荐工作。

十、保荐机构认为应当说明的其他事项

无其他应当说明的事项。

十一、保荐机构对本次上市的推荐结论

本机构认为，发行人申请其股票上市符合《公司法》《证券法》及《首发办法》《创业板上市规则》等法律、法规的规定，发行人股票具备在深交所创业板上市的条件，同

意推荐发行人在深交所创业板上市。

（以下无正文）

(本页无正文,为《中国国际金融股份有限公司关于托伦斯精密制造(江苏)股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的上市保荐书》之签章页)

法定代表人:



陈亮

2026年2月14日

保荐业务负责人:



孙雷

2026年2月14日

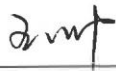
内核负责人:



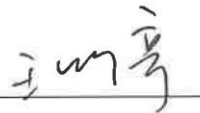
章志皓

2026年2月14日

保荐代表人:



王帅



王竹亭

2026年2月14日

项目协办人:



梁劲

2026年2月14日

保荐人公章

中国国际金融股份有限公司



2026年2月14日